

# L'unité de revêtement HiPIMS



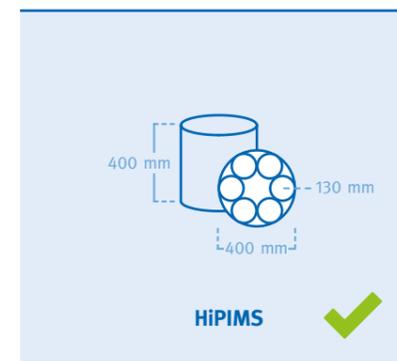
Le CC800® HiPIMS combine tous les avantages de la technologie classique de pulvérisation DC avec les possibilités de la dernière technologie HiPIMS. L'unité est équipée de 6 cathodes de pulvérisation, dont 4 qui peuvent être utilisées soit en mode HiPIMS, soit en mode DC. Les deux cathodes DC supplémentaires peuvent être utilisées notamment pour la fabrication de revêtements complexes, pour la production de couches de couleur et de couverture ou simplement pour augmenter les taux de revêtement. En combinant ces techniques dans un procédé, il est possible de produire une variété jusqu'ici jamais atteinte de revêtements

de manière extrêmement économique. En mode HiPIMS pur, il est possible d'atteindre des taux de revêtement de 2 µm/h et des durées de traitement de 4 à 5 heures. Lorsque les 6 cathodes fonctionnent simultanément, le taux atteint est de 3 µm/h. Et cela, combiné à un niveau de remplissage allant jusqu'à 1 800 outils continus ou 5 000 plaques de coupe jetables. Le CC800® HiPIMS est en mesure de produire tous les revêtements de pulvérisation existants de CemeCon et pratiquement tous les revêtements PVD disponibles sur le marché. En outre, c'est la machine parfaite pour développer des processus spécifiques au client. L'interface

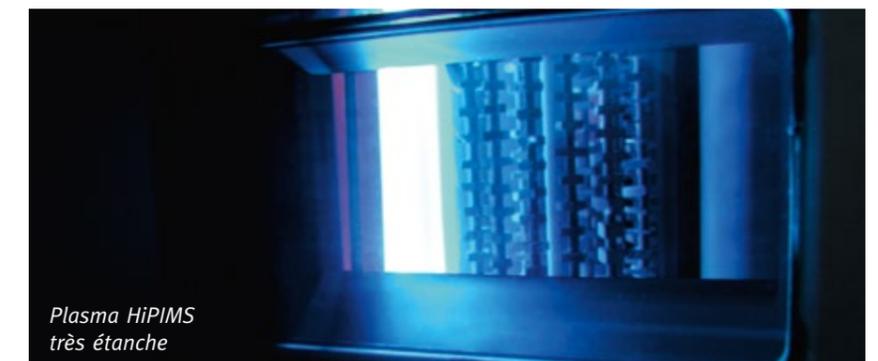
utilisateur conviviale « DataView » et l'outil de planification intégré « DataPlan » permettent de développer des solutions de revêtement exclusives. Les utilisateurs peuvent ainsi se démarquer sur le marché et obtenir un avantage concurrentiel. D'autres caractéristiques telles que le logiciel de maintenance à distance par tablette ou téléphone, la structure à faible maintenance, le volet à cathodes entièrement automatique, le ferme-porte automatique ou la table à changement rapide complètent le CC800® HiPIMS et en font un système de revêtement optimal pour la production et le développement de revêtements modernes à haute performance.

CC800® HiPIMS		
Surface de revêtement, Ø x h	[mm]	Ø400 x 400
Plateau de substrat, Ø x Ø des satellites x nombre de satellites	[mm], pièce	Ø400 x Ø130 x 6
Plateau de remplacement rapide		en option
Cathodes de pulvérisation	pièce, [mm]	6 x 500 (dont 4 HiPIMS/DC au choix et 2 autres DC ; toutes les cathodes sont équipées de volets)
Dimensions maximales du substrat, Ø x h	[mm]	Ø400 x 800
Capacité foreur, Ø6 mm x 60 mm	pièce	1.800
Capacité de la plaque de coupe jetable, 12,7 mm x 3,5 mm	pièce	4.920
Charge	[kg]	250
Taux de couche	µm/h	En mode HiPIMS, 2 µm/h ; en mode DC ou en mode combi jusqu'à 3 µm/h
Durée de cycle pour 3 µm FerroCon®*	[h]	4,5
Procédé		HiPIMS et pulvérisation à l'aide de la technologie Booster. Tous les revêtements CemeCon établis sont possibles.
Traitement de substrat (gravures plasma)		Gravures Booster, MF et HiPIMS
revêtements conducteurs d'électricité		oui
revêtements non conducteurs d'électricité		oui
substrats non conducteurs d'électricité		oui
Puissance connectée	[kW]	80
Consommation d'électricité par charge pour 3 µm FerroCon®*	[kWh]	120
Dimensions extérieures (L x P x H)	[mm³]	1.450 x 3.350 x 2.200
Poids à vide	[kg]	~ 3.500
Verrous de porte		automatique

## VOLUMES DE REVÊTEMENT



\* Couche HiPIMS pure sur fraise de 10 mm



Plasma HiPIMS très étanche

## HiPIMS HIGH POWER IMPULSE MAGNETRON SPUTTERING

### Cathodes



### BIAS



La commande tactile intuitive et les entraînements pneumatiques des portes de chambre facilitent le travail quotidien avec l'unité.